

**國家科學及技術委員會中部科學園區管理局**  
**112 年度中部科學園區專業及技術人才培訓計畫**

課程名稱：發光二極體技術發展與未來應用

課程簡介：

本課程將從 LED 晶片製作、LED 封裝和 LED 應用等方面介紹基本概念與相關技術，詳細講解 LED 封裝過程中和開發應用產品時應該注意的一些技術問題，並以引腳式 LED 封裝為基礎，進一步介紹了平面發光式、SMD、大功率 LED 的三種不同封裝形式及其相應的產品在實際生產中的操作技術。最後引出 LED 扇外型封裝(FOWLP)與 Micro LED 的挑戰。

上課時間	課程名稱	課程綱要	講師	上課地點
2023/07/20(四) 9:00~16:00	發光二極體技術發展與未來應用	1.LED 概述 (LED 的基本概念/結構與發光原理/特點及常用性能指標/晶片分類等) 2.LED 熱流分析 (熱流模擬模型設計與分析) 3.LED 封裝簡介 (LED 封裝原則/各類封裝工藝簡介) 4.LED 扇外型封裝的挑戰 (FOWLP 工藝簡介與應用) 5. Micro LED 的挑戰	中興大學電機工程學系暨光電工程研究所劉浚年專案助理教授	線上課程軟體：Google Meet

報名方式:

1. 網路網址：<https://forms.gle/cQdwBeZkCPf4kANF8>
2. Email 報名：d875212@gmail.com 鄭小姐 andii@nchu.edu.tw 劉先生
3. 電話報名：04-36068996#1007 鄭小姐 #1008 劉先生



備註：

註 1：本課程全程免費，歡迎報名參加。中部科學園區（包含台中園區、后里園區、虎尾園區、二林園區及中興園區）園區事業從業員工、中部科學園區管理局職員、國家科學及技術委員會創新創業激勵計畫團隊成員、園區外各產業從業人員或中部地區大專院校應屆畢業生。（因名額有限，若報名人數過多或資格不符，本計畫辦公室保有篩選報名人員之權利），報名成功者將另以電子郵件通知。

註 2：本課程受訓學員出席率達上課總時數 80% 者，可獲頒訓練證明書。

註 3：本課程需收取保證金新台幣 2,000 元，報名成功者請按通知電子郵件所述繳費方式依限繳交。報名學員上課出席總時數達 80% 者課程結束後退回，未達 80% 者將沒收保證金不予退還，完成課程者可全額退還，亦可保留延用至下次課程！

註 4：請自備電腦或其他裝置連線上課，教學軟體使用方式再另以電子郵件通知。

註 5：計畫網站：<https://110caic.com/>

講師資訊：

講師現職	最高學歷	講師專長
中興大學電機工程學系暨光電工程研究所專案助理教授	國立中山大學光電工程研究所	光通訊、半導體雷射、螢光材料製程與光電模組構裝、光機電系統設計與開發